

连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > LGA 插座 > LGA 2011 Sockets



IC 插座类型: LGA 2011

位数: 2011

端子接合区域电镀材料厚度: [15 μ in]

中心线 (间距) : 1.02 mm [.04 in]

PCB 端接方法: 表面贴装 - 焊球

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	2011
栅格间距	1.016 x .8814 mm [.040 x .0347 in]

主体特性

框架种类	正方形
------	-----

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子基材	铜合金
IC 插座类型	LGA 2011
	15 μ in
端子额定电流 (最大值)	.5 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装 - 焊球
----------	-----------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
壳体颜色	黑色
中心线 (间距)	1.02 mm[.04 in]

使用环境

工作温度范围	-25 – 100 °C[-13 – 212 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

托盘颜色	蓝色
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月 (223) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。

免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1554653-1_H.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1554653-1_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1554653-1_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[6-1773461-9_LGA_2011_SOCKET](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

1554653-1

SOCKET ASSY LGA2011, 0.38Au

